

# Call for Papers

# ICEP-IAAC 2012

Joint Conference of "International Conference on Electronics Packaging"  
and "IMAPS All Asia Conference"

会期: 2012年4月18日(水)~20日(金)

会場: 東京ビッグサイト 会議棟

共催: エレクトロニクス実装学会(JIEP), IEEE CPMT Society Japan Chapter, IMAPS

2012年のICEPは、IAAC(International All Asia Conference)とのJoint Conferenceです。  
IAACは、日本、韓国、台湾の各国持ち回りで開催します。第1回目の2012年は日本で開催します。日本での開催はICEPとのJoint Conferenceとなります。今回募集する論文はICEPでの発表です。  
エレクトロニクス実装学会(JIEP)では米国IMAPSからオールアジアでの学会開催の要請を受け、国際委員会、ICEP組織委員会を中心に検討し、アジア各国での輪番開催を提案いたしました。これに対し、アジア各国の実装キーマンバーから賛成の回答があり、第1回は日本で開催することになりました。以降は、台湾、韓国で開催される予定です。

## ●論文発表

### [口頭発表]

発表言語は英語です。エレクトロニクス実装学会の規程によりベストペーパー賞が授与されます。  
また、IEEE CPMTの規定により、35歳未満の方を対象にヤングアワードが授与されます。

### [ポスター発表]

発表言語は英語です。エレクトロニクス実装学会の規程によりポスター賞が授与されます。

## ●論文募集分野(Session名及びKeywords)

### (1) Advanced Packaging

Area Array Packages, SiP, PoP, PiP, Wafer Level Packaging, System Integration, LCD Modules, MCM, System on Package

### (2) Substrate

Laminates, Interposers, Fine Pitch, Build-up Substrates, Flexible Printed Circuits, Embedded, Conductive Paste, Thin Core, Coreless, Low CTE, Thin Film Wiring

### (3) Design, Modeling, and Reliability

Signal Integrity, Power Integrity, High Speed Board Design, Reliability, Failure Analysis, Testing, Evaluation, EDA

### (4) Thermal Management

Advanced Cooling Modules, Fans and Blowers, Heat Pipes, Heat Sinks, Micro and Nano Scale Heat Transfer, Optical Devices, Power Devices, Thermal Interface Materials, Thermal Measurements, Thermoelectrics

### (5) Manufacturing and Process

Flip Chip, Plating, Inkjet, Process Control, Equipment, Thin Films, Underfills, Encapsulation, Molding, Fluxes

### (6) Interconnection

Flip chip, Wire Bonding, Soldering, Bump Formation, Chip Package Interaction, Low k, NCF/NCP, ACF/ACP, Leadframe, Surface Finishes, BGA, Fluxless Joining

### (7) Optoelectronics

Photonic Devices, Optical Fibers, Waveguides, Optical Interconnects, Transceivers, Connectors, LD/PD, LED, OE/EO, TOSA/ROSA, WDM, Optical Wiring Boards

### (8) Printed Electronics

Inkjet, Screen Printing, Conductive Wiring, Insulation, Printed Organic TFT, Device Applications

### (9) 3D and TSV

Silicon stacking, Chip on Chip, Chip on Wafer, Wafer on Wafer, TSV, Via Formation and Filling, Wafer Thinning, Wireless Interconnection, 3D LSI Design and CAD System

### (10) MEMS/Sensor

MEMS/Sensor Devices, Process, Assembly and Packaging, System Integration, MOEMS

### (11) Self-Organization/Self-Assembly

Nano Materials/Devices by Self-organization/Self-assembly, Dissipative Structures, Hierarchical Structures, Bottom-up Manufacturing Bio-mimetic, Nature-oriented Processes/Design/Applications

### (12) Emerging Technologies

Nano Technology, Nano Imprint, Organic Semiconductors

### (13) RF

RFID, High Frequency Devices, Packaging, Filters, EMI, EMC, Antennas

### (14) Automotive Electronics

Power Devices, Power Electronics, ECU, Sensors, Lead Free Solder, Wire Harness

### (15) Energy and Environment

PV, Lead Free, Fuel Cells, Power Electronics, Power Devices, Energy Efficient Package Design

### (16) Metrology

Current Density, Power Map, Thermal Map,

### (17) Others

Market Trends, Environmentally Conscious Product and Processes, Cost Analysis

## ●アブストラクト(300ワード)の締切: 2011年11月29日(火)

アブストラクトは英文300ワード以内です。図、表、写真はいずれか1点を貼付していただいても結構です。  
登録方法はホームページ <http://www.jiep.or.jp/icep/> に掲載いたします。[8月中旬 登録開始予定]

## ●採否通知: 2011年12月初旬

採否の通知はEメールでお送りします。

## ●本論文提出期限: 2012年2月13日(月)

本論文は4から6ページです。ポスター発表の方も論文を執筆してください。  
「執筆要領」は採否通知後にお知らせいたします。

## ●発表者参加費(ポスター発表の方も必要です。)

- ・発表者 40,000円(論文集、Reception、消費税を含む)
- ・学生 5,000円(論文集、消費税を含む)

発表論文採否通知後にあらためて参加登録をしていただきます。

## ●組織委員会

委員長: 折井靖光(日本アイ・ビー・エム)  
副委員長: 山道新太郎(ルネサスエレクトロニクス)  
野上義生(東レエンジニアリング)  
安東泰博(フジクラ)

## ●問合せ・連絡先

ICEP2012 組織委員会事務局  
(社団法人エレクトロニクス実装学会)  
TEL: 03-5310-2010 FAX: 03-5310-2011  
E-mail: [icep2012@jiep.or.jp](mailto:icep2012@jiep.or.jp)

